

**各種電極に対して、安定した耐落下衝撃特性を発揮**

Provides stable drop impact resistance for various types of electrodes

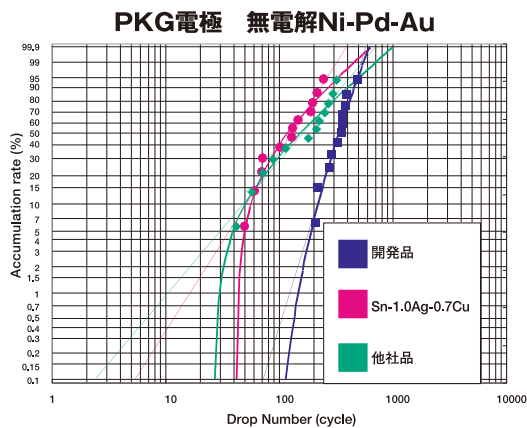
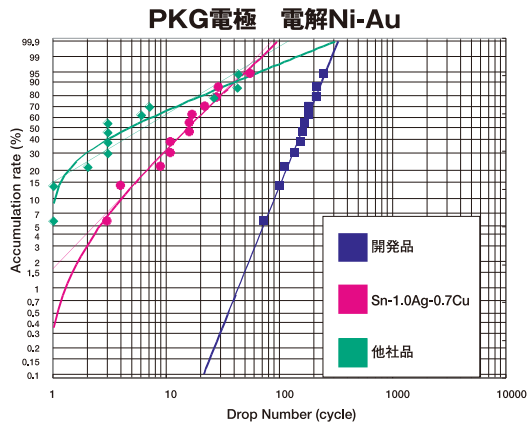
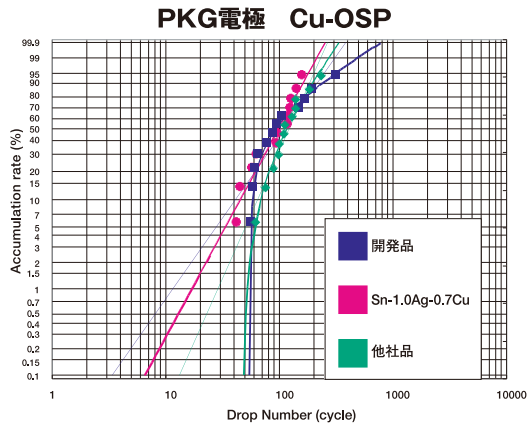
**特長**

- ソルダボール用途、Sn-Ag-Cu+ $\alpha$ 。
- 各種電極に対して高い耐落下衝撃信頼特性。

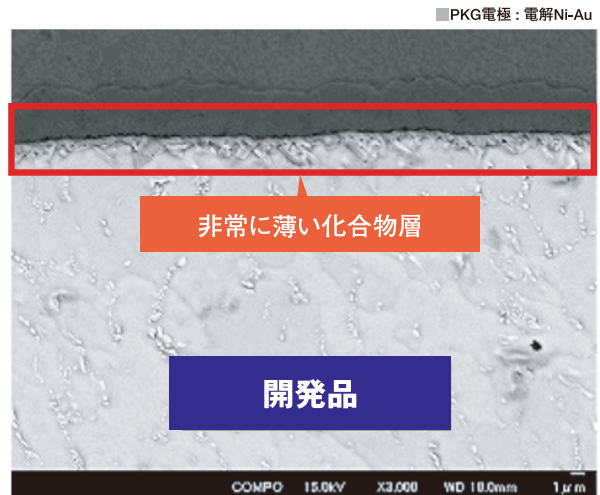
**製品仕様**

□ 繰り返し落下試験結果

■ 基板電極 : Cu-OSP  
■ ソルダボール : 0.3mm



□ 接合界面写真



■ 推奨プロファイル  
昇温速度 : 1~5°C/秒  
ピーク温度 : 240~250°C  
230°C Over : 30~40秒  
冷却速度 : -5.0deg./C/秒